アルミニウムテーパチップを用いた 400 nm と 800 nm における 超高速プラズモンパルスナノ集光

Grating-Coupled Nanofocusing of Ultrafast Surface Plasmon Pulses at 400 and 800 nm

using an Aluminum Tapered Tip.

富田恵多 (B4), 小島 康裕 (M2)

Keita Tomita, Yasuhiro Kojima

Abstract

We achieve nanofocusing of ultrafast surface plasmon polariton (SPP) pulses simultaneously at 800 and 400 nm using an aluminum tapered tip formed through electro-chemical etching for the first time. We measure the SPP intensity and phase at the tip apex and obtain plasmon response functions for the both wavelengths, which represent the SPP propagation along the aluminum tapered tip.

1. はじめに

表面プラズモンポラリトン (SPP) は,電磁波を 金属・誘電体界面に光の回折限界を超えて閉じ込め ることができるため,サブ波長域の光デバイスへ の応用が注目を集めている. SPP とは,金属表面に おける電磁波と自由電子の集団的な振動が結合し たモードである[1].特に,フェムト秒レーザパルス 励起によるサブ波長領域への超高 SPP ナノ集光 を用いれば,時間および空間的に局在した光励起が 可能となる.手法の一つとして,2007年に Ropers は回折格子構造を有す金属テーパチップへフェム ト秒レーザパルス励起の SPP を結合させること でチップ先端へのナノ集光を実現した[2].

SPP を励起するには、金属の複素誘電率の実部

が-1より小さく、虚部がより小さいことが必要で ある.可視領域のプラズモニック材料として使用 されている金や銀は紫外領域ではこの必要条件を 満たさないが,アルミニウム(Al)は紫外領域でもこ の必要条件を満たす[3].したがって、AlはSPPを 紫外領域で励起するのに適した材料である.我々 は,これまで金を用いて波長800 nmで実現してき たSPPナノ集光[2,4]を波長400 nmで実現すべく, フェムト秒レーザをAlテーパ構造に刻んだ回折格 子を介してSPPパルスを励起し,波長400 nm と 800 nmのSPPナノ集光を実現した.

本研究では、フェムト秒レーザパルスで励起され た Al テーパ先端の SPP 特性を解析するために、相 互相関暗視野顕微鏡を用いた.

2. FDTD シミュレーション

最初に、本研究に用いた Al テーパチップを用いた 800 および 400 nm における SPP パルスのナノ集光についてのシミュレーション結果を述べる. Al テーパチップの形状は、断熱的集光伝播が起きるよう先端角 15°, 全長 10 μ m、底面の半径 1.3 μ m である. Fig.1 にそのシミュレーションモデルを示す.励起には CW 光をチップの底面から垂直方向に入射させた.また、CW 光の波長は 800 と400 nm, 偏光は y 方向の直線偏光と設定した. **Fig.2**にそのシミュレーション結果を示す. **Fig.2**より, 800 と 400 nm のどちらの場合においても,先端でナノ集光が生じていることが確認できた.



Fig. 1 Simulation model.



Fig. 2 SPP intensity at a tapered waveguide surface calculated by FDTD simulation at 800 and 400 nm.

次に、本研究に用いた Al テーパチップの回折格 子パラメータの最適値を求めるために行ったシミ ュレーションについて述べる.アルミニウムプロ ーブの先端角は 15°, 先端から最初の溝までの距 離は 10 μm, 最後の溝から終端までの距離は 3 μm である.励起光の中心波長は 800 と 400 nm, パル ス幅 10 fs とし、プローブの長軸方向に対して垂直 にコリニアに入射させた.集光スポットサイズは 8 μ m であった. Fig.3 に回折格子を刻んだ Al プロー ブの構造を示す.回折格子の溝の周期, 幅, 深さ, 本数について順に述べる.



Fig. 3 Structure of Al tapered tip.

(i)回折格子の周期の決定[1]

回折格子の周期は, Bragg の回折条件より以下 の式で表される. 左辺の第 1 項が伝搬する表面プ ラズモンの項, 右辺の第 1 項が回折格子に関する 項,第 2 項は入射光の表面プラズモンの伝搬軸方 向への波数ベクトルである. ここで, k_{SPP}は表面プ ラズモンの波数, k₀とθは入射光の波数と入射角, 次数mは自然数である.

$$k_{SPP} = k_0 \sin\theta + m \frac{2\pi}{R}$$

上式は以下のように変形できる。

$$\frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_{r_1}\varepsilon_{r_2}}{\varepsilon_{r_1} + \varepsilon_{r_2}}} = \frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta + m\frac{2\pi}{P}$$

 ε_{r1} は金属の比誘電率, ε_{r2} は誘電体の比誘電率, cは 光速, λ は入射光の波長である. 今回は, 同一の回 折格子パラメータで 800 nm と 400 nm の光パルス を伝搬させるため, $\lambda = 800$ nm と 400 nm におい て周期 Pは同一である. よって, $\lambda = 800$ nm にお いて次数 m = 1 で, $\theta = 7.5^{\circ}$ とすると, 周期は 911 nm と求まる. また, 周期が 911 nm のとき, $\lambda =$ 400 nm において次数 m = 2 とすると, $\theta = 8.38^{\circ}$ と 計算できる. ここで, λ = 800, 400 nm において, 入射角の差が 1°以下なので,同軸で 400 nm と 800 nm の光パルスを入射することとする.

(ii) 回折格子の溝幅の決定

(i)から,回折格子の周期Pは911 nm と決定した.回折格子の溝幅wは周期に対して1/6,1/4, 1/3,2/5,1/2,2/3,4/5倍の値を用い,溝の深さ dは200 nm,溝の本数nは6本を用い,それぞれモ デルを作成し,先端におけるパワー密度を計算した 結果をFig.4に示す.Fig.4より,溝幅wはパワー 密度が最大となる300 nm と決定した.



Fig. 4 Dependence of coupled SPP intensity on width of groove

(ⅲ)回折格子の溝の深さの決定

(i)と(ii)から,回折格子の溝の周期Pは911 nm, 溝幅wは300 nm と決定した。回折格子の溝の深さ *d*を50,100,150,200,300,400 nm と変化させ, 溝の本数nは6本を用い,それぞれモデルを作成し, 先端におけるパワー密度を計算した結果を Fig.5 に示す.Fig.4.7より,溝の深さ*d*はパワー密度が最 大となる100 nm と決定した.



Fig. 5 Dependence of coupled SPP intensity on depth of groove

(iv)回折格子の溝の本数の決定

(i)~(iii)から,回折格子の溝の周期Pは911 nm, 溝幅wは300 nm,溝の深さdは100 nmと決定し た.回折格子の溝の本数nを1~8 本まで一本ずつ 増やしたモデルをそれぞれ作成した。結合効率とス ペクトル幅をFig.6 に示す.



Fig. 6 Coupled efficiency and spectrum of width

Fig.6より,結合効率は回折格子の溝の本数が増 えるにしたがって線形に増加し,スペクトル幅は 溝の本数が増えるにしたがって線形に減少するこ とがわかった.今回,溝の本数は結合効率が最大 となる8本と決定した.以上より,回折格子のパラ メータを決定した.

アルミニウムテーパチップの作成 及び回折格子加工

最初に、電解研磨法による Al テーパチップの作成 に つ い て 述 べ る. 電 解 研 磨 法 は 主 に STM(scanning tunneling microscope)や NSOM(Near field scanning optical microscopy)において用いられる金属プローブを簡便に作成する方法として頻繁 に用いられる手法である[5].





電解研磨法は金属ワイヤと金属の対極を酸や塩 基を含む電解溶液に浸し、このワイヤと対極の間 に電圧を印可することによって, 金属ワイヤを電 解溶液中で電気分解によって徐々に削り、 ワイヤ の先端をナノオーダの細さまで研磨していく手法 である. 実験セットアップは Fig.7 のように濃塩酸 (35%)と濃硝酸(70%)と純水の混合溶液を電解溶液 として使用した. Al テーパチップを作成する素材 として, 陽極には純度 99.95 %の $\phi = 50 \mu m O Al$ ワイヤ(株式会社ニラコ製)を使用した.また、陰極 には、 $\phi = 1 \text{ mm}$ のAlワイヤを折り曲げ、半径10 mm のリング状にしたものを使用した. 陰極側の Al リングは、3/4 だけ沈むように配置し、Al ワイヤ は液面から 2~3 mm だけ沈むように配置した.研磨 の際には、陽極と陰極に電圧を印可する必要があ るが、この直流電源によって印可電圧を供給した.

電解研磨中は,溶液と Al ワイヤの間で以下のよう な反応が生じている.

(anode)

$$2Al(s) + 3H_20 \rightarrow Al_2O_3(s) + 6H^+(aq) + 6e^{-3H_2O_3(s)}$$

$$Al_2O_3(s) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 3H_2O$$

(cathode)

$$2\mathrm{H^+}(\mathrm{aq}) + 2\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{H_2}(\mathrm{g})$$
$$\mathrm{HNO_3}(\mathrm{aq}) + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{NO_2}(\mathrm{g}) + \mathrm{H^+}(\mathrm{aq}) + \mathrm{O^{2-}}(\mathrm{aq})$$

このとき研磨は AI ワイヤと接している部分で行わ れるが, 先端形状が数十 nm のテーパチップを得 るためには、電解研磨の終了と同時に印可電圧を すばやく切断する必要がある.これは、研磨終了時 に余計な電圧をかかり続けると、作成したテーパ チップがさらに研磨されてしまい, 先端の形状を 変化させてしまう可能性があるからである. 今回 の電解研磨システムでは,研磨終了と同時に電圧 を切断するために陰極からの電流を Microcomputer Board を用いて計測し、電流値が 0 になった瞬間、 スイッチリレーに電圧を印可して回路を短絡させ ることで、AIワイヤの陽極の印可電圧を0Vにした. 作成したAIテーパチップは精製水を用いて洗浄し, SEM(Scanning Electron Microscope : TM3030, HITACHI)を用いて観察した. なお、数十 V 等の 高電圧で電解研磨を行うと副次的な電気分解反応 として塩素や酸素が電極で泡となってしまい、表 面が非常に汚くなるため数 V 等の低電圧で行う必 要がある. さらに、金ワイヤの電解研磨とは異なり、 Al の場合は、イオン化傾向が水素より高いために、 電解研磨の際、過剰な水素の泡が発生し、 テーパチ ップ先端を揺らすため、先端曲率半径が数十 nm のテーパチップを作成するのは困難であると言わ れている.

(i) 薬品混合比を変化させたときのアルミニウ ムワイヤ電解研磨特性

Alテーパチップの先端曲率半径が最小で,表面 形状が滑らかなものを得るために,まずの濃塩酸, 濃硝酸と純粋の薬品混合比の最適化を行った.印 可電圧は6Vで固定した.濃硝酸と純粋の混合比を 変化させたときのSEM画像をFig.8に示した.スケ ールバーは100 μ mである.体積比をHCl:HNO₃: H₂O = a:b:cと定めて,この結果から傾向を見る と,以下の結論が得られた。

- b(HNO₃)が増加するごとに、先端曲率半径は小 さくなっていき、テーパ部は長くなっていく、
- c(H₂O)が増加するごとに、先端曲率半径は大きくなっている.a<bのときはa=bより先端曲率
 半径の増加率は小さい.また、cが増加するごとにテーパ部は短くなっていく.
- a=c<b かつ b=3aのとき、先端曲率半径は最小になっている.また、a=cのときはどの場合でも、先端曲率半径は200 nmより小さい値となっている.

電解研磨終了時間は,数百 msから数 sであった. 濃硝酸を増加させると,不動態である酸化Alの膜 厚が増加し,電解研磨終了するまでの濃塩酸と酸 化Alの反応時間が長くなる.これにより先端曲率 半径が小さくなるように作用しているのだと考え られる.以上より,体積比HCl:HNO₃:H₂O=1:3: 1で印加電圧6 Vのとき,先端曲率半径150 nmのAl テーパチップが得られた.



Fig. 8 SEM image of Al tapered tips when changing chemical mixture ratio.

(ii) 印加電圧を変化させたときのアルミニウ ムワイヤ電解研磨特性

次に印可電圧値の最適化を行うために、2.0 Vか ら8.0 Vまで0.5 V間隔で電解研磨を行なっていく. 体積比HCl: HNO₃: H₂O = 1:3:1と固定したとき のSEM画像をFig.9に示した.これらの結果から傾 向を見ると、以下のことが明らかとなった。

- 印加電圧2 V~3 Vのとき、テーパ部の長さが200 µm程度であり、先端曲率半径は200 nm~300
 nmである。
- 印加電圧3V~4.5 Vのとき、テーパ部の長さが 100 µm程度と短くなり、先端曲率半径は150 nm~200 nmである.
- 印加電圧4.5V以上のとき、印加電圧を大きくしていくと、テーパ部の長さが大きくなる.印加電圧が4.5 V~5.5 Vのとき先端曲率半径は減少する.また、印加電圧が5.5 V以上のとき、先端

曲率半径は増加する.

以上より、体積比HCl:HNO₃:H₂O=1:3:1で印 加電圧5.5 Vのとき、表面が十分滑らかな先端曲率 半径120 nm,先端角度15°のAlテーパチップが得 られた.





次に, Al テーパチップの表面に回折格子を, FIB(Focused Ion Beam)加工装置(Quanta 3D 200i, FEI 株式会社製)を使用して刻んだ. 回折格 子のパラメータは, 周期 911 nm, 幅 300 nm, 深さ 100 nm, 溝の本数 8 本とする. Fig.10 に, 作成した 回折格子が刻まれた Al テーパチップの SIM 画像を 示した.



Fig. 10 SIM image of Al tapered tip with diffraction grating structure.

4. 実験セットアップ

相互相関暗視野顕微計測の実験セットアップを Fig.11 に示す. 光源は, Ti:Sapphire フェムト秒レー ザ"VENTEON"を使用した。スペクトル帯域 600-1000 nm, パルス幅< 8 fs (FWHM), 繰り返し周 波数 150 MHz, 平均パワーは 150-180 mW である. 励起光が直接,検出側の対物レンズに入射しないよ うに、励起方向と検出方向を 90°の位置関係にして 暗視野計測を行っている.光源から出射されたレ ーザ光を,結晶長2mmのType-IBBO結晶に入射 させることで第二高調波を発生させた. ビームス プリッターで信号光と参照光の2 つのパルスに分 け,信号光は半波長板で偏光方向を調整し,軸外し 放物面鏡(焦点距離=20.3 mm, NA=0.35)によって、 テーパチップに対して垂直方向でチップ表面の回 折格子に照射され SPP を励起する. 励起光のスポ ットサイズは800 nm では約8 µm,400 nm では約4 μm である.. ナノ集光した SPP はチップ先端で散 乱し、その散乱光を対物レンズ(×40, NA=0.55, 作動距離=3.4 mm)を用いて入射方向と垂直方向の CCD カメラに入射させた. 信号光は回折格子に照 射し先端からのもう一方の参照光は遅延時間をつ けて CCD に直接入射することで信号光と干渉させ た. 信号光と参照光の重ね合わせは, CCD カメラ を見ながらアライメントを行った. 遅延時間を走 査させることでフリンジ分解電界相互相関関数を 求めた. 遅延時間はピコモータを用いて分解能が 約 0.125 fs の遅延時間差をつけている. CCD は露 光面が 5.7 mm×4.3 mm で 650×480 pixel であり, イメージ分解能は 1pixel で約 1 μm の 分解能を もつ.



Fig. 11 Experimental setup of cross-correlation dark-field imaging.



Fig. 12 Spectrum of VENTEON and second harmonic generation by a Type-I BBO crystal.

5. 実験結果

(i) ナノ集光イメージング

Fig. 13 に 800 nm と 400 nm で Al テーパチップを 励起したときの CCD イメージをそれぞれ示す.回 折格子は Fig. 10 で示したように先端から 10 μ m の位置に刻まれている. 800 nm と 400 nm どちらの 場合においても,回折格子に照射した集光スポッ トサイズ約 8 μ m と約 4 μ m 光により,表面プラ ズモンが励起され,先端まで 10 μ m 伝搬してナノ 集光している様子がわかる.







(ii) 偏光依存特性

チップ先端の SPP 散乱光強度を測定する. CCD の前に検光子を配置して測定した先端散乱光の偏 光特性を Fig. 14 に示す. 座標系と角度は Fig. 10 に 従う. 励起光は x 方向から入射され, 先端散乱光は y 方向から検出している. 先端散乱光の偏光方向は チップの軸方向に沿った偏光成分を持っているこ とがわかる. これは, SPP モードの偏光は導波路表 面つまり伝播方向に対して垂直方向のみであるが, 先端部では SPP モードの偏光成分が足し合わされ て,その結果として先端ではチップの軸方向の偏光 成分が強くなるためである.



Fig. 14 Polarization characteristics of apex emitted light. (a) at 800 nm, and (b) at 400 nm.

(iii) プラズモン応答関数計測 [6]

相互相関暗視野顕微計測により, Al テーパチッ プの伝達関数であるプラズモン応答関数を求めた. 信号光と参照光を重ね合わせ,遅延時間をピコモ ータで走査することでフリンジ分解電解相互相関 計測を行った.スペクトル位相はプラズモンによ るスペクトル位相変化のみを抽出する必要がある. そこで,回折格子励起位置の信号光と参照光の相 互相関波形と,チップ先端位置の SPP パルスと参 照光の相互相関波形を計測しフーリエ変換するこ とによって求める.その 2 つの相互相関波形によ り, Al テーパチップを伝搬する際に加わるスペク トル位相のみを抽出することができる. 測定した 相互相関波形を Fig. 15 に, ナノ集光 SPP の結 合・伝播・再放射のプラズモン応答関数を Fig. 16 に示す.



Fig. 15 Cross-correlation waveform.



Fig. 16 Plasmon response functions at the apex representing SPP coupling at the grating, propagating, and re-emission.

(a) at 400 nm, and (b) at 800 nm.

さらに, 取得した Fig. 16 のプラズモン応答関数 のスペクトル位相と SPP スペクトル強度より, 本 実験に用いた励起パルスの帯域で制限されたイン パルス応答関数をを Fig. 17 に示す. Fig. 17 より先 端での SPP のパルス幅は, 800 nm のとき 7.8 fs, 400 nm のとき 50.6 fs であった. 400 nm でのインパルス 応答時間幅が長いのは、本実験の 400 nm パルスが 長いためで、その帯域制限を受けている。本質的に はフェムト秒域の応答があるはずである。この結果 より, アルミニウムテーパチップ表面を SPP が超 高速性を保ったままナノ集光していることがわか る.



Fig. 17 Time waveforms at the apex with a FTL excitation pulse. (a) at 400 nm, and (b) at 800 nm.

6. まとめ

FDTD シミュレーションにより, Al テーパチップ を用いた波長 800 と 400 nm での SPP ナノ集光を確 認し, 最も効率良く SPP が伝播する回折格子のパ ラメータを決定した. 電解研磨法により, 先端曲率 半径 120 nm の Al テーパチップを作成し, FIB によ ってパラメータ通りの回折格子を刻んだ. フェム ト秒レーザパルス励起による Al テーパチップに結 合した SPP ナノ集光を 800 nm と 400 nm において 確認した. また, 相互相関暗視野顕微計測によって, Al テーパチップの伝達関数であるプラズモン応答 関数を求めた. 今後, 同一の Al テーパチップを使 用した 800 nm と 400 nm の SPP ナノ集光を利用し た新しいポンプ-プローブ法, 二光子励起の可能性 を示した.

Reference

[1] H. Raether, Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and Grating (Springer, 1988).

[2] C. Ropers, C.C. Neacsu, T. Elsaesser, M. Albrecht,M. B. Raschke and C. Lienau, Nano Lett. 7, 2784 (2007).

[3] A.D. Rakic, A.B. Djurisic, J.M. Elazar, and M.L. Majewski, Appl. Opt. 37, 527 (1998).

[4] K. Toma, Y. Masaki, M. Kusaba, K. Hirosawa andF. Kannari, J. Appl. Phys. **118**, 103102 (2015).

[5] Ren, B., Picardi, G. & Pettinger, B, Rev. Sci. Instrum. 75, 837–841 (2004).

[6] S. Onishi, K. Matsuishi, J. Oi, T. Harada, M. Kusaba, K. Hirosawa, and F. Kannari, Opt. Express. 21, 26631 (2013).